

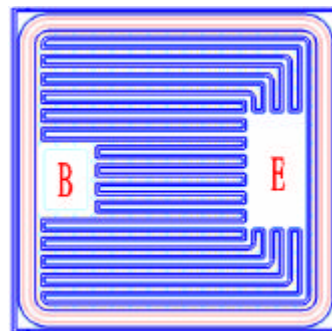


13007 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：D320AG-00
芯片厚度：240±20μm
管芯尺寸：3200×3200μm²
焊位尺寸：B 极 560×740μm²；E 极 560×1080μm²
电极金属：铝
背面金属：银
典型封装：KSE13007，HE13007

管芯示意图

极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

T _{stg}	贮存温度	-55~150
T _j	结温	150
P _C	集电极功率耗散（T _c =25℃）	80W
V _{CBO}	集电极—基极电压	700V
V _{CEO}	集电极—发射极电压	400V
V _{EBO}	发射极—基极电压	9V
I _C	集电极电流（DC）	8A
I _C	集电极电流（脉冲）	12A
I _B	基极电流	4A

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV _{CEO(sus)}	集电极—发射极维持电压	400			V	I _C =10mA，I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =9V，I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V，I _C =2A
		5		30		V _{CE} =5V，I _C =5A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			1	V	I _C =2A，I _B =0.4A
				2	V	I _C =5A，I _B =1A
				3	V	I _C =8A，I _B =2A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和电压			1.2	V	I _C =2A，I _B =0.4A
				1.6	V	I _C =5A，I _B =1A
C _{ob}	共基极输出电容		110		pF	V _{CB} =10V，f=0.1MHz
f _T	特征频率	4			MHz	V _{CE} =10V，I _C =0.5A
t _{ON}	导通时间			1.6	μs	V _{CC} =125V，I _C =5A， I _{B1} =-I _{B2} =1A
t _{STG}	载流子贮存时间			3	μs	
t _F	下降时间			0.7	μs	